

特点:

图片

- 低插入损耗: 典型值 2.7dB
- 高带外抑制: $\geq 70\text{dB}$ @ $f_0 \pm 25\text{MHz}$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- 封装尺寸: 27×12×7mm
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=25℃)

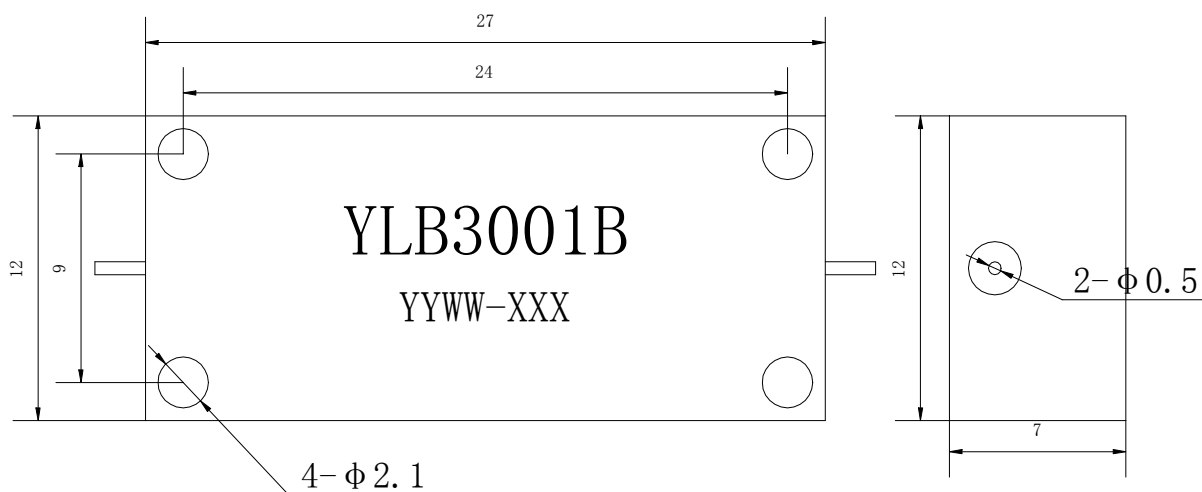
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		70±0.5			MHz	全温
-3dB 带宽	BW _{-3dB}		8.0		10.0	MHz	全温
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=70\text{MHz}$		2.7	3.5	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=67 \sim 73\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR ₁	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1 \sim 45\text{MHz}$	70.0	82.0		dB	全温
	SR ₂	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=95 \sim 300\text{MHz}$	70.0	88.0		dB	全温
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				10.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位
输入射频功率	+30.0	dBm
贮存温度	-55~+100	℃

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志：

YLB3001B	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

接口标识	接口说明
玻珠	RF IN, RF OUT (可互换)
腔体	GND

产品使用注意事项：

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.模块用 M2 螺钉固定在外腔体中，装配时先用螺钉装配后再进行引脚焊接；
- 3.绝缘子采用锡铅焊接，烙铁焊接温度为 280℃~350℃，每个焊点焊接时间≤3s。
- 4.装配时，应保护好绝缘子，不能使其弯折。
- 5.拆卸时，需用吸锡带将每个焊点的焊锡清理干净。
6. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 7.产品属于磁性敏感器件，产品在运输、储存过程中应注意远离磁场环境，产品设计应用时应考虑强磁环境对该器件的磁性影响。



8. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
9. 其他使用说明注意事项参考《成都宇熙产品使用说明》相关要求。